

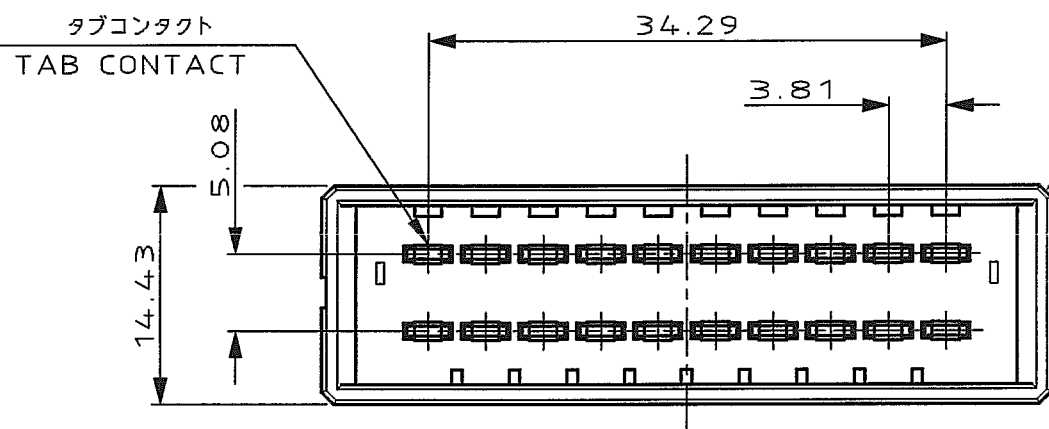
NUMBER 178328



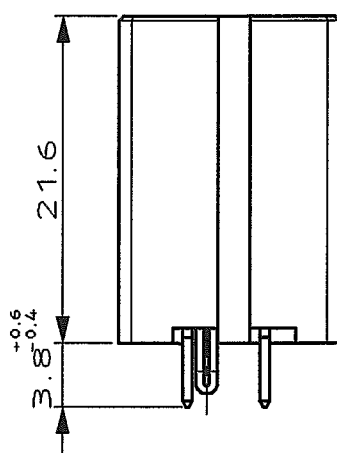
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

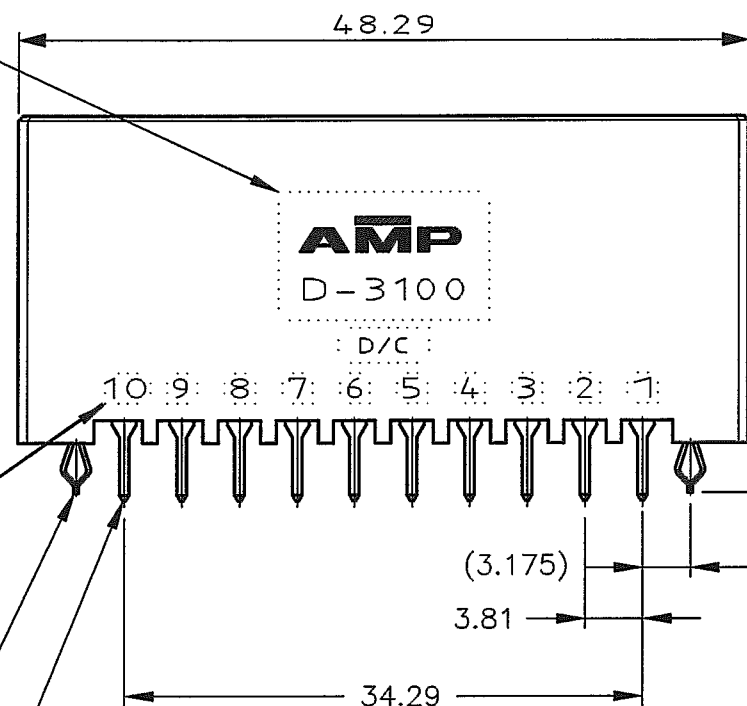
PRINT DIST



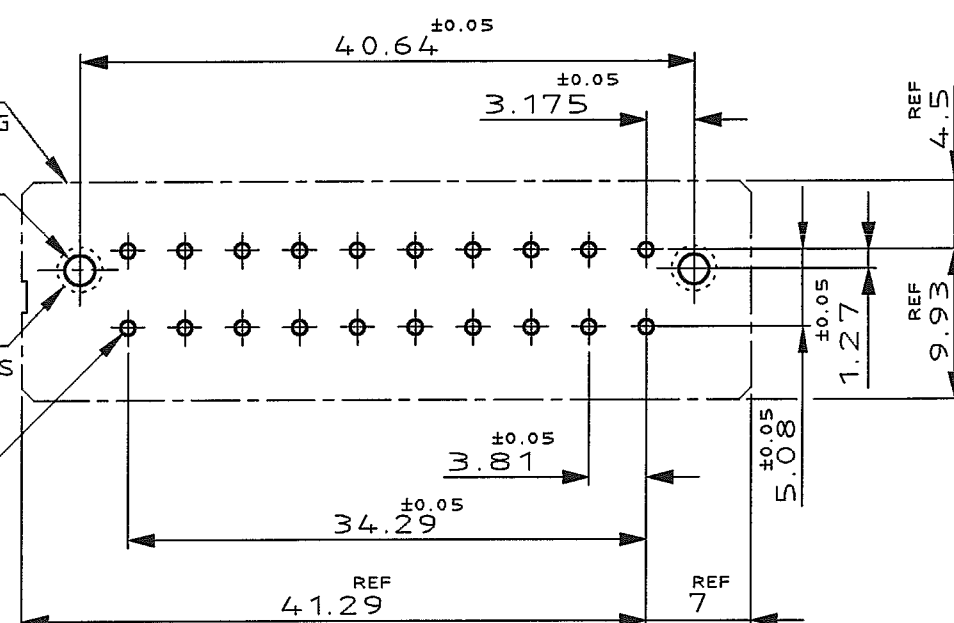
AMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK



回路番号
CIRCUIT NO
リテンションレグ
RETENTION LEG
コンタクト半田付部
CONTACT TAIL



コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING
スルーホール 2-φ2
DIA 2±0.1 2PLACES
ラウンド 2-φ3MIN
ROUND DIA 3MIN 2PLACES
20-φ1.1
DIA 1.1±0.1 20PLACES



推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 色: 黒色
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

△6	△4	178328-5
△6	△3	178328-3
△6	△2	178328-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME	
mm² (AWG -)		mmφ	20POS DOUBLE ROW	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照	VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
DR. 20-JAN-'93 Y. TANAKA		DE. 20-JAN-'93 Y. TANAKA		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
CHK. 8-FEB-'93 S. MANABE		APP. 8-FEB-'93 S. MANABE		10mm以下 : ±0.3 10mm以上 30mm以下 : ±0.4 30mm以上 100mm以下 : ±0.5 角度 : ±3°
				SIZE A3 LOC J NUMBER C-178328
				SCALE 2-1 REV. D1 SHEET 1 OF 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[178328-2](#)